

2025年2月13日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料WG

主査 藤尾侑輝

副査 上原雅人、蔭浦泰資

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム 令和7年度 第3回 センシング材料WG講演会のご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

本WGでは、産総研が開発する世界トップクラスのセンシング材料：窒化物薄膜（ScAlN、GaScN等）、ダイヤモンド、湿式酸化物薄膜等の最新の研究開発動向（材料開発、材料特性、製造方法）、社会課題に対する応用展開に関して、産総研、大学、企業の研究者を交えた議論を行っています。今回の講演会では、産総研研究者の希有な技術として、超伝導検出器による放射光分析技術、THz帯電磁波による分析技術、和周波分光法による分析技術に着目し、各技術のトップランナーの産総研研究者に技術紹介を行っていただきます。ご出席宜しくお願い致します。

敬具

記

日時：2026年3月11日（水） 10:00～11:45（9:45 受付開始）

会場：Microsoft Teamsを活用したオンライン会議

申込締切：2026年3月9日（月）

10:00～10:05 開会挨拶

センシング材料 WG 主査 藤尾 侑輝

10:05～10:35

依頼講演「超伝導検出器による放射光分析」

産総研 センシング技術研究部門 主任研究員 志岐 成友

10:35～11:05

依頼講演「テラヘルツ光分析：計測技術と非破壊検査事例の紹介」

産総研 センシング技術研究部門 主任研究員 鈴木 大地

11:05～11:35

依頼講演「和周波発生分光を活用した表面・界面分析（仮）」

産総研 センシング技術研究部門 研究員 佐藤 友哉

11:35～11:40 総合討論

11:40～11:45 閉会挨拶、事務連絡等

センシング材料 WG 主査 藤尾 侑輝

※プログラムは変更する可能性があります。

※個人情報、コンソーシアム活動及びセンシング技術研究部門の広報活動に限定して使用させていただきます。

お問い合わせ先：

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料 WG 事務局

（国研）産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

E-mail: M-stri-SenTePack-material-ml@aist.go.jp